

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 46, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 16 a 19 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no Processo MDIC nº 52000.020057/2006-22, de 29 de dezembro de 2006, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para o produto UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO MONTADA EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 225, de 24 de dezembro de 2009, passa a ser o seguinte:

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuitos impresso, que implementem as funções de processamento central (placa-mãe) e memória, sendo que, quando a placa-mãe for do tipo monoprocessada, deverão ser montadas as placas de rede local e fax-modem, conforme cronograma estabelecido no inciso III do art. 4º.

II - montagem das partes elétricas e mecânicas; e

III - integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.

Parágrafo único. Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico estabelecido nesta Portaria, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto a etapa constante do inciso III, que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se como UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO MONTADA EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, as unidades digitais montadas em um mesmo corpo ou gabinete dotadas de placa mono ou multiprocessada (placa-mãe) montada com componentes, sendo a multiprocessada dotada de pelo menos 2 (dois) soquetes individuais para processadores independentes, ou microprocessadores independentes montados em placas com barramento de conexão à placa-mãe.

§ 1º Adicionalmente ao estabelecido no caput o servidor deve apresentar características da seguinte configuração mínima:

I - capacidade de gerenciar no mínimo 4 Gigabytes de memória - ECC (Error Correction Code), e também utilizar memória com tecnologia ECC na sua configuração;

II - interface de comunicação para unidades de discos rígidos com taxa de transferência mínima de 160 MByte/s;

III - possibilidade de configuração mínima de armazenamento de memória em unidades de disco rígido de 160 Gbytes do tipo hot swap; e

IV - possibilidade de estabelecer espelhamento mirroring ou outras tecnologias de recuperação automática de dados armazenados em unidades de disco rígido.

§ 2º Ficam dispensados de atender o inciso III do § 1º os servidores que, por configuração para aplicações específicas, não disponham do recurso hot-swap como servidores do tipo Diskless, Clusters de Load Balancing para servidores Web, Clusters para computação de alto desempenho, servidores de pequeno e médio porte para aplicações de baixa criticidade em geral que contenham apenas um disco interno, servidores tipo blades entre outras configurações para aplicações específicas.

Art. 3º Para o cumprimento do disposto no caput do art. 1º ficam temporariamente dispensados da montagem local, observado o disposto no art. 4º, os seguintes módulos, subconjuntos ou unidades:

I - unidade de discos magnéticos rígidos e flexíveis;

II - unidade de disco óptico;

III - fonte de alimentação;

IV - gabinete;

V - placas com função de memória secundária utilizadas em placas controladoras de vídeo e de discos;

VI - leitor biométrico; e

VII - sensor de impacto.

Art. 4º Para o cumprimento do disposto no caput do art. 1º ficam estabelecidos os seguintes cronogramas de utilização de componentes, partes e peças produzidos conforme os respectivos Processos Produtivos Básicos, cujos percentuais serão estabelecidos tomando-se por base a quantidade total dos respectivos componentes utilizados nas unidades digitais de processamento do tipo servidor, produzidas e incentivadas no ano calendário:

I - Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente a função de processamento central (placa-mãe):

Ano calendário	2009 em diante
Percentual montado (monoprocessadas)	90%
Percentual montado (multiprocessadas)	20%

II - Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem as funções de memória, produzidas de acordo com seu Processo Produtivo Básico:

Ano calendário	2007 em diante
Percentual montado	80%

III - Placas de fax-modem até 56 kbps e placas de rede até 100 Mbps utilizadas nos servidores monoprocessados:

Ano calendário	2008 em diante
Fax-modem: Percentual montado	80%
Placas de rede: Percentual montado	80%

IV - Demais componentes, partes e peças que atuem com a função de memória, quer sejam em forma de circuitos integrados, quer em forma de módulos ou placas, tais como os citados abaixo ou outras tecnologias, quando aplicável:

- a) Componente circuito integrado Nand Flash (FBGA- Fine pitch Ball Grid array / LGA- land grid array);
- b) Componente circuito integrado DRAM ou LPDRAM (FBGA);
- c) Componente eMMC (Multi Media Card) (FBGA / LGA);
- d) Componente eSSD (FBGA / LGA);
- e) Módulo SSD - (Small Form Factor Solid State Drive);
- f) Cartão de memória µSD card; e
- g) Unidade de armazenamento de dados SSD (Solid State Drive) com circuito integrado MCP (Multi Chip Package) denominado iSSD (Integrated Solid State Drive).

Ano calendário	2012	2013	2014	2015 em diante
Percentual mínimo exigido com PPB específico	-	30%	50%	60%

§ 1º A base de cálculo sobre a qual incidirão os percentuais será sobre o total de componentes e módulos, descritos no inciso IV, que atuem com a função de memória, observando o disposto no §2º deste artigo, ficando a critério do fabricante a opção de escolha para integrar nos percentuais estabelecidos.

§ 2º Para efeito de cumprimento dos percentuais definidos no inciso IV deste artigo, os circuitos integrados de memórias deverão ser contabilizados individualmente, mesmo que apresentados em placas ou módulos com mais de um circuito integrado.

§ 3º Exclusivamente para o ano de 2012, ficam dispensadas da obrigatoriedade constante do inciso IV as memórias do tipo: NAND Flash e LPDRAM sendo que, de 2013 em diante, deverão ser produzidas de acordo com o cronograma estabelecido no inciso IV.

§ 4º As memórias do tipo MCP (Multi Chip Package - FBGA / LGA), deverão obedecer ao seguinte cronograma de exigência de percentuais mínimos obrigatórios:

Ano calendário	2012	2013	2014	2015	2016	2017 em diante
Percentual mínimo exigido com PPB específico	-	-	-	20%	40%	60%

§ 5º Ficam dispensados das obrigatoriedades constantes deste artigo os seguintes chips de memória, presentes nas placas-mãe: Basic Input-Output system - BIOS; Graphics Double Data Rate - GDDR; e Cache.

§ 6º Os servidores monoprocesados que tiverem as funções descritas no inciso III do art. 4º implementadas na placa-mãe terão seus percentuais equivalentes considerados atendidos.

§ 7º Os servidores multiprocessados estão dispensados do cumprimento estabelecido no inciso III do art. 4º.

§ 8º Alternativamente ao disposto no cronograma estabelecido no inciso I do art. 4º a empresa poderá optar por substituir a montagem das placas multiprocessadas, nos mesmos percentuais dos servidores produzidos e incentivados, com placas multiprocessadas, por uma ou mais das alternativas abaixo, isolada ou combinadamente:

I - utilização de gabinete produzido de acordo com seu Processo Produtivo Básico;

II - utilização de fonte produzida de acordo com seu Processo Produtivo Básico;

III - utilização de disco rígido produzido de acordo com seu Processo Produtivo Básico;
ou

IV - exportação de servidores.

§ 9º O percentual complementar de placas monoprocesadas não montadas no País a que se refere o inciso I do art. 4º está limitado, em termos de quantidade, a 6.000 (seis mil) unidades por ano e por fabricante.

§ 10. Ficam dispensados da obrigatoriedade constante nos incisos I e II do caput do art. 1º os respectivos percentuais complementares estabelecidos no art. 4º.

§ 11. Caso os percentuais estabelecidos no art. 4º não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a compensar a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano seguinte, sem prejuízo das obrigações correntes, no ano-calendário.

§ 12. A diferença residual a que se refere o § 11 não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

§ 13. As placas de interfaces de comunicação com tecnologia sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, WiMax), destinadas às UNIDADES DE PROCESSAMENTO MONTADAS EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, deverão atender ao seguinte cronograma de montagem, tomando como base a quantidade de utilização dessas placas, no ano calendário:

I - de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010: dispensado;

II - de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011: 20% (vinte por cento);

III - de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013: 50% (cinquenta por cento); e

IV - de 1º de janeiro de 2014 em diante: 80% (oitenta por cento).

Art. 5º As empresas fabricantes deverão apresentar, quando aplicável, autorização do cedente da tecnologia quando da habilitação da empresa à redução ou isenção do IPI, prevista no Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 6º Anualmente, as empresas fabricantes deverão encaminhar à Secretaria de Política de Informática - SEPIN, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e à

Secretaria do Desenvolvimento da Produção - SDP, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, até 31 de maio do ano posterior, relatório consolidado com as seguintes informações:

I - insumos adquiridos no mercado nacional e produzidos de acordo com seus respectivos Processos Produtivos Básicos;

II - identificação do fabricante fornecedor (Razão Social e CNPJ);

III - quantidade de UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO MONTADA EM UM MESMO CORPO OU GABINETE, DO TIPO SERVIDOR, comercializadas com e sem incentivos; e

IV - informações referentes à utilização dos percentuais, previstos nesta Portaria.

§ 1º As informações deverão ser encaminhadas em mídia digital (CD, DVD, Pendrive etc.) acompanhadas de uma correspondência com aviso de recebimento (AR).

§ 2º O não envio das informações acima citadas por parte da empresa, ressalvado o direito de defesa, bem como o não cumprimento dos percentuais estabelecidos nesta Portaria caracterizará o não cumprimento do Processo Produtivo Básico, ficando a empresa sujeita às penalidades previstas no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, e no art. 36 do Decreto nº 5.906, de 2006.

Art. 7º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 225, de 24 de dezembro de 2009.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

MARCO ANTONIO RAUPP

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação